

令和5年度

京都実装技術研究会 オープニングセミナー

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、令和5年度の会員募集に先立ち、参加費無料のオープニングセミナーを以下のとおり開催します。

- ◇ 開催日時 令和5年5月30日（火） 13:30 ~ 17:00
- ◇ 開催方式 Web／会場参加 併用（講師は会場でのご講演です）
- ◇ 会場 京都府産業支援センター 5階 研修室
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）
- ◇ 内容
【世界半導体産業・技術の流れと日本の立ち位置】

講師：国際技術ジャーナリスト・News&Chips編集長・セミコンポータル編集長
津田 建二 氏

世界の半導体は今、どのような方向に向いているのか、それに対して日本の立ち位置はどうなっているか。半導体をけん引するドライバは電機からITへ変化し、世界の半導体はデジタル化へまっしぐらに進んでいる。次のトレンドであるIoT、5G、AI、そしてメタバース、さらに生成AIの時代を迎え、半導体はどう対応するのか。日本復活に向けたヒントは世界の成功企業にある。パワー半導体は世界と対抗できるのか。世界のヒントと今後の半導体のあるべき姿を描く。

- ◇ 定員 会場：40名 Web：40名
- ◇ 参加費 無料
- ◇ 申込締切 令和5年5月26日（金）まで
- ◇ 申込方法 当センターホームページからお申し込みいただけます。
（ <https://www.kptc.jp/> ）
※E-mail 又はFAXでもお申し込みいただけます。
- ◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
（京都実装技術研究会事務局）
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

令和5年度 京都実装技術研究会 オープニングセミナー申込書

会社名			
所在地			
連絡担当者	所属・役職		
	氏名		
	E-mail		
	電話番号		
参加者	所属・役職	氏名	
参加方法	<input type="checkbox"/> 会場参加 <input type="checkbox"/> Web 参加		
研究会入会の案内を希望※1		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	

※1 すでに入会申込済みの方は「しない」にチェックを付けて下さい。

※2 申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、1 事業所 1 接続でお願いします。複数名で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 会場には消毒液を設置し、会場の窓や扉の開放等による換気、他の受講者との間隔をあける等の対策をいたします。ご来所の際は手洗いか手指消毒をお願いします。また、発熱等の症状がある方はご来場をお控えください。